

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Arrowpoint Investment Partners (Hong Kong) Limited、GIC、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、LST Capital Partners Shanghai Consulting Limited、Millennium Capital Management(Hong Kong) Limited、Passage investment、Willing Capital Management Limited、Zaaba Capital Limited、安徽弘开投资、安信基金、百年保险资产、柏駿資本管理(香港)、鲍尔赛嘉(上海)投资、北京沅沛投资、北京汉和汉华资本、北京鸿道投资、北京君创富民资产、北京磐泽资产、北京神农投资、北京阳光天泓资产、北京颐和久富投资、北京泽铭投资、贝莱德资产管理北亚、博裕投资、财通证券、财信基金、辰泰顾问、诚通证券、创金合信基金、淳厚基金、大家资产、德邦基金、第一證券、鼎和财产保险、东方阿尔法基金、东方财富证券、东方证券、东吴人寿保险、敦和资产、方瀛研究與投資（香港）、復星财富、富安达基金、富兰克林邓普顿投资(亚洲)、高盛資產管理(香港)、高维私募基金、新华养老保险、工银理财、光大永明资产、广东省粤科融资担保、广东天创私募证券投资基金、广发基金、广发证券、广州昱阳私募基

	金、廣發鈺券(香港)經紀、国华兴益保险资产、国金证券资产、国联安基金、国盛证券、国寿安保基金、国泰基金、国泰君安证券、国投瑞银基金、国信证券、國泰君安國際控股、國泰證券投資信託、海富通基金、海港人寿保险、博荣私募基金、恒洵投资、冲和投资、金蟾蜍投资、浩成资产、禾永投资管理(北京)、和谐健康保险、红华资本管理(深圳)、红土创新基金、湖南百弘资产、华安财保资产、华福证券、华富基金、华泰证券、华泰资产、华夏久盈资产、华夏未来资本、华源证券、汇丰晋信基金、汇丰前海证券、汇添富基金、嘉实基金、嘉澤基金、建信基金、建信理财、羿鹏私募基金、交银施罗德基金、锦成盛资产、劲恒投资、景顺长城基金、九泰基金、开源证券资管、兰馨亚洲投资集团、利安人寿保险、美林(亞太)、民生加银基金、明毅基金、摩根大通证券（中国）、摩根士丹利基金管理（中国）、摩根证券投资信托、沐杉投资、南方天辰(北京)投资、天奥投资、紫熙投资、宁波数法私募基金、诺德基金、盘羿资本、鹏扬基金、平安基金、平安资产、淇琳投资、前海人寿保险、青岛国信产融控股(集团)、青岛国信创新股权投资、泉果基金、群益证券投资信托、融通基金、瑞士银行（中国）、睿遠基金(香港)、润晖投资咨询（北京）、三井住友德思資產管理(香港)、山河资本、山西证券、山证资产、壁仞科技、博笃投资、不动山投资、翀云私募基金、大箏资产、丹羿投资管理、德焱投资、砥俊资产管理中心、东方证券资产、枫润资产、复需投资、复胜资产、高瓴创业投资、格传私募基金、固信投资控股、瀚伦私募基金、珩道投资、汇正财经顾问、健顺投资、玖鹏资产管理中心、珺容投资、开思股权投资基金、宽格投资、犁得尔私募基金、理成资产、聆泽私募基金、明河投资、摩旗投资、盘京投资、上海汽车集团金控、千河资产、
--	---

	青沔资产、趣时资产、筌笠资产、熵盈私募基金、尚硕投资、尚雅投资、深梧资产、盛宇股权投资基金、听畅资产、彤源投资发展、潼骁投资发展中心、旺旺食品集团、沃珑港资产、仙人掌私募基金、相生资产、相生资产、银叶投资、于翼资产、上海证券、、上投摩根基金、道朴私募、固禾私募、恒邦兆丰私募、金之灝基金、凯丰投资、珞瑜私募、逆为投资咨询、前海万方投资、易同投资、长青藤资产、正向投资、望正资产、展博投资、中安汇富私募、中胤信弘投资、盛博香港、世纪证券、世嘉控股集团(杭州)、苏桥资本、永鑫方舟股权投资管理、太平基金、太平洋资产、太平资产、泰康基金、西部利得基金、西部证券、西藏长金投资、西藏中睿合银投资、香港汇丰银行、新华基金、鑫元基金、信达证券、兴合基金、兴业证券、兴银理财、兴证证券资产、阳光资产、野村东方国际证券、野村國際(香港)、易米基金、盈峰资本、友邦人寿保险、煜德投资、誉辉资本管理（北京）、允泰投资、张家港高竹私募基金、长安基金、长城财富保险资产、长城证券、长江证券资产、长盛基金、招商证券资产、浙江国信投资、浙江秘银投资、浙江省创新投资私募基金、浙商证券、致合（杭州）资产、中庚基金、中国人保资产、中投國際(香港)、中信保诚资产、中信建投基金、中信建投证券、中银基金、中銀國際、中邮创业基金、众安在线财产保险、重庆德睿恒丰资产、重庆三福投资、重庆泽栩资产、洲和资本、长乐汇资本、鹭实投资等 372 位机构及个人投资者
时间	2026年08月27日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	1、董事、总裁：赵启祥 2、副总裁、董事会秘书：朱溪瑶 3、财务总监：朱国强

投资者关系活动主要内容介绍	一、2026 年上半年经营业绩回顾 2026 年，人工智能技术加速向各领域渗透，全球 AI 基础设施与算力需求持续扩张，高端 PCB 市场成长空间广阔。在此背景下，胜宏科技全体员工凝心聚力，坚定“拥抱 AI，奔向未来”的战略方向，深度绑定国际头部客户，持续优化产品结构，强化核心技术壁垒，拓展优质客户资源，推进高端产能建设，为行业中长期需求做好产能储备，助力公司稳步增长。2026 年上半年，公司实现营业收入 116.29 亿元，同比增长 28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 28.57 亿元，同比增长 33.30%，主要得益于： （1）AI 算力赛道高景气，公司产品结构持续优化 报告期内，公司精准把握 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮的历史性机遇，持续巩固在全球 PCB 制造领域的技术领先地位。公司凭借行业领先的技术能力、品质能力、交付能力和全球化服务能力，成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴。在 AI 算力、数据中心、高性能计算、光模块等关键领域，多款高端产品已实现大规模量产，带动产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，高端产品占比持续提升，支撑公司业绩稳步增长。 （2）深耕算力市场，优质客户拓展顺利 报告期内，公司新拓展客户数量超 50 家，其中一半以上为 AI 领域高端客户。一方面，公司依托与全球头部算力、通信等终端大客户的深度协同，在产品迭代、技术创新、供应链保障等方面持续精进，市场影响力与行业话语权不断增强，高价值量业务占比持续提升。在 ASIC 算力芯片领域，公司与相关客户业务合作进展顺利，深度参与产品合作研发，部分相关 PCB 产品已实现量产。另一方面，公司积极拓展国产算力业务，国内高端产品业务规
----------------------	--

	模稳步增长，国内算力领域合作版图持续拓宽。公司将持续优化客户结构，强化核心技术与产品竞争力，巩固公司在高端算力 PCB 领域的市场地位。 （3）强化技术壁垒，巩固行业领先地位 2026 年上半年，公司充分发挥自身技术优势，深度参与客户产品预研，深化与全球头部科技行业客户战略合作。公司率先突破高多层与高阶 HDI 相结合的核心技术壁垒，具备 100 层以上高多层板制造能力，是全球首批实现 6 阶 24 层 HDI 产品大规模生产及 16 层任意互联（Any-layer）HDI 技术能力的企业。公司成功攻克 30 层 10 阶 HDI、36 层 14 阶 HDI 核心制造工艺，高端高阶 PCB 制程能力迈上新台阶。积极推进 70 层以上铜浆烧结、垂直供电埋容高多阶 HDI 以及 COWOP 先进封装基板技术落地，满足 AI 算力服务器、高端通讯领域的高阶 PCB 量产需求。公司在 AI 算力卡、AI Data Center UBB&交换机市场份额全球领先。根据 Prismark 数据，公司位列全球 PCB 供应商第 7 名，中国大陆内资 PCB 厂商第 4 名。 （4）强化成本及供应链管理，持续降本增效 2026 年上半年，面对行业原材料供应偏紧、价格波动频繁的市场环境，公司持续强化供应链管控与成本精细化管理。针对原材料价格波动风险，公司建立动态应对机制，密切跟踪大宗商品及 PCB 核心原材料价格走势，结合市场行情与下游客户积极协商产品定价，合理、有序传导原材料成本压力。同时，公司深化与核心原材料头部供应商的战略合作关系，搭建稳定、多元的供应体系，目前，公司与主要原材料供应商已建立了稳定的合作关系，原材料采购渠道通畅、库存储备合理，整体物料供应稳定。 二、互动交流环节具体情况如下：
--	---

	1、请介绍一下公司的产能规划进展和资本开支计划？ 答：公司 2026 年固定资产投资计划金额不超过 180 亿元，主要投向国内扩产。厂房四是分阶段投产，一季度完成设备的安装连线，上半年处于爬坡状态，产能释放主要配合客户放量节奏。厂房四包含部分 mSAP 产能，目前光模块对于该部分产能需求旺盛。厂房十已开始第一阶段的设备搬入及调试，下半年将陆续推进剩余设备的安装及试生产工作；厂房十一尚处于土建阶段，进度将取决于土建施工与设备到位情况。此外，近期公司已摘牌华侨城（惠州）产业园，该产业园与现有惠州园区土地相邻，完成转让后将规划建设 mSAP、HDI 等高端 PCB 产能。 2、Vera Rubin、TPU V8等新产品开启生命周期，如何看待2026年下半年到2027年的行业景气度，以及新产品对公司业务的拉动？ 答：新一代产品已经进入大批量生产阶段。此外核心算力、通信等客户项目推进符合预期。目前公司在手订单饱满，订单能见度处于历史高位，高多层、高阶 HDI 类高端产品排单已经延续至 2027 年。公司扩产产能均有确定性订单与需求做支撑，以推动后续公司业务成长。 3、看到国内算力在明年的资本开支加速释放，那么国内对公司PCB的需求是否会成为公司新一轮增长点？国内客户的产品品类和产能规划的展望？ 答：2026 年是国内算力元年，国内算力需求大幅超出公司年初的预期。绝大多数客户都在持续上调需求；也看到国产 GPU、国产算力解决方案客户的订单需求逐步明确，部分客户订单稳定性、订单能见度持续改善。
--	---

	从 PCB 的单价、性能要求等方面看，海外头部大客户的算力方案仍是行业最领先，新一代产品 PCB 单价实现倍数级增长，国内算力方案产品相比海外顶级方案，从单价、材料方向看，仍存在一定差距。 4、PCB行业呈现半导体化趋势，线宽线距越来越精细，如何看待技术升级带来的挑战，公司核心技术壁垒体现在哪里？ 答：每一次产品迭代伴随着产品单价成倍的增长，一方面来自材料的变化升级，另一方面来自工艺和结构的变化。因为很多的特殊材料需要使用特殊的加工工艺、设备，才能达到稳定的批量生产，这需要工厂产线长期磨合调教、海量实验积累、高效管理体系、快速响应及问题解决能力，这些形成了大家看到的供应商的壁垒。实验室小批量样品相对更容易实现，但真正难点在于大规模量产稳定交付。 此外，公司也在不断推进新材料、新技术的研发，如石英玻璃布、PTFE、陶瓷、埋铜等，各方案均配合客户需求进行沟通与推进。量产落地的方案不仅会考虑新材料方案的性能达标，也需要兼顾产能和交付能力。因此技术配合或者产能的配合，需要供应商与客户进行深度绑定和沟通、及时响应。 5、海外大客户对海外生产基地有什么诉求？新一代产品是否会转移至海外基地生产？泰国基地规划如何？ 答：部分海外客户存在海外生产需求，海外项目建设、设备调试、人员培训、产业链配套周期更长，同时综合生产成本高于国内，因此主要客户将订单优先放在国内生
--	---

	产，仅部分终端产品受限的特殊客户，会要求海外生产。 预计今年下半年到 2027 年海外订单将逐步落地起量。目前公司海外项目的建设依旧紧迫，从资本开支角度看，可能后续泰国基地还会增加 capex。按 2-3 年的长期维度，海外客户需求多样性更高，海外基地具备重要战略意义。 6、二季度毛利率受到一定压制，如何展望下半年及明年走势？ 答：原材料价格波动对毛利率影响较小，Q2 毛利率承压主要来自两大因素：一是人员储备扩张，员工规模上半年增幅超 30%，大量人员处于培训储备阶段，为后续订单生产做准备；二是新厂房设备持续转固，折旧增加。因为人工、产能都需要走在订单前面，不能让订单等产能，所以存在时间差。 从现在往后看，新产品良率爬坡相关工作已经在准备，公司对于未来盈利能力充满信心，后续伴随着营收规模上台阶后，毛利率有望同步向上。 7、未来 AI PCB 收入占比展望，AI 业务内部大客户与 ASIC、国产方案结构怎么看？ 答：去年 AI 产品营收占比约一半；预计未来非 AI 业务营收绝对金额基本保持平稳，增量主要来自 AI 类产品。海外头部大客户业务将维持高增速，公司预期份额保持稳定，营收增速跟随大客户自身节奏；ASIC、国产算力方案业务增速更高，但当前体量偏小，短期大客户仍在 AI 收入中占较高比重。
--	---

	8、二季度存货大幅增长约 20 亿元，存货构成是什么？ 答：二季度存货增加主要是公司积极备货，为下半年新产品大规模量产、快速交付做储备，公司原材料和在产品增加。 9、AI 高端覆铜板价格上行背景下，对大客户价格传导情况如何？ 答：公司与大客户合作维持相对稳定的毛利率水平。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年8月27日